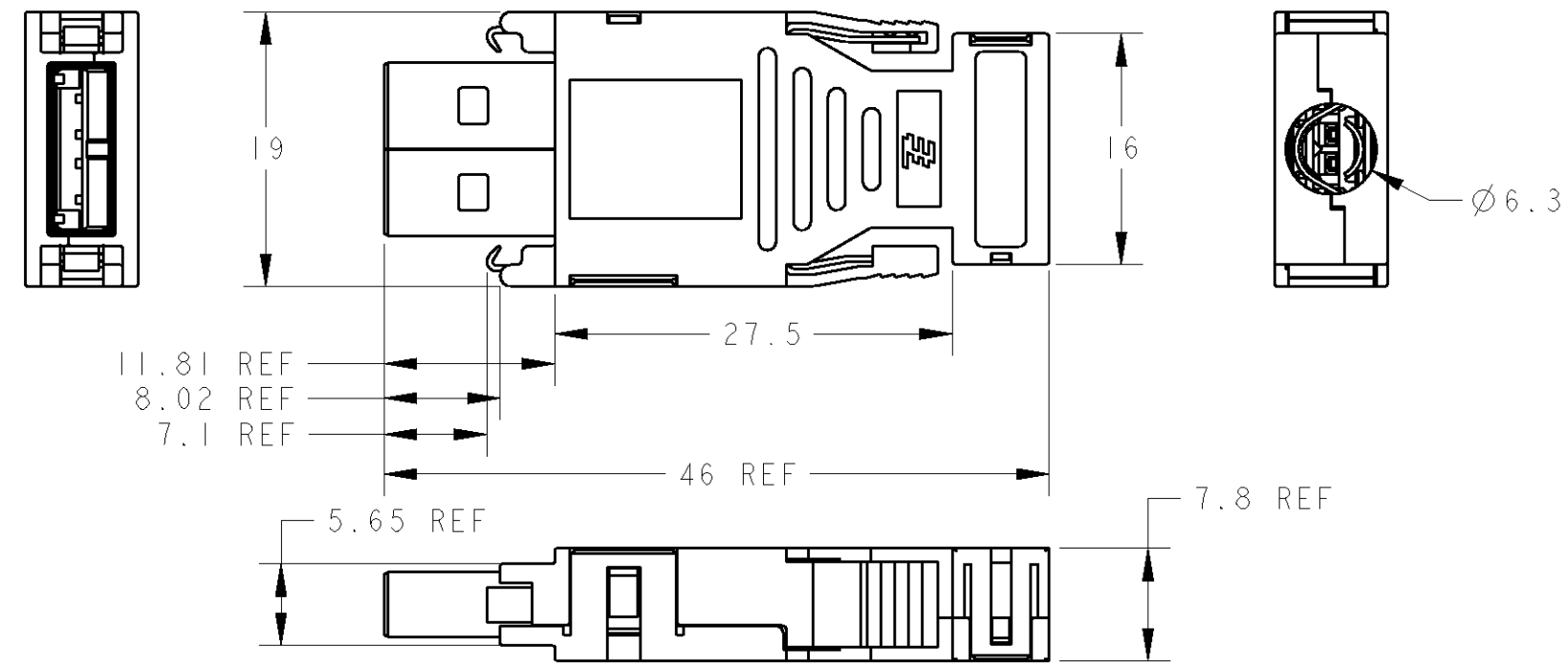


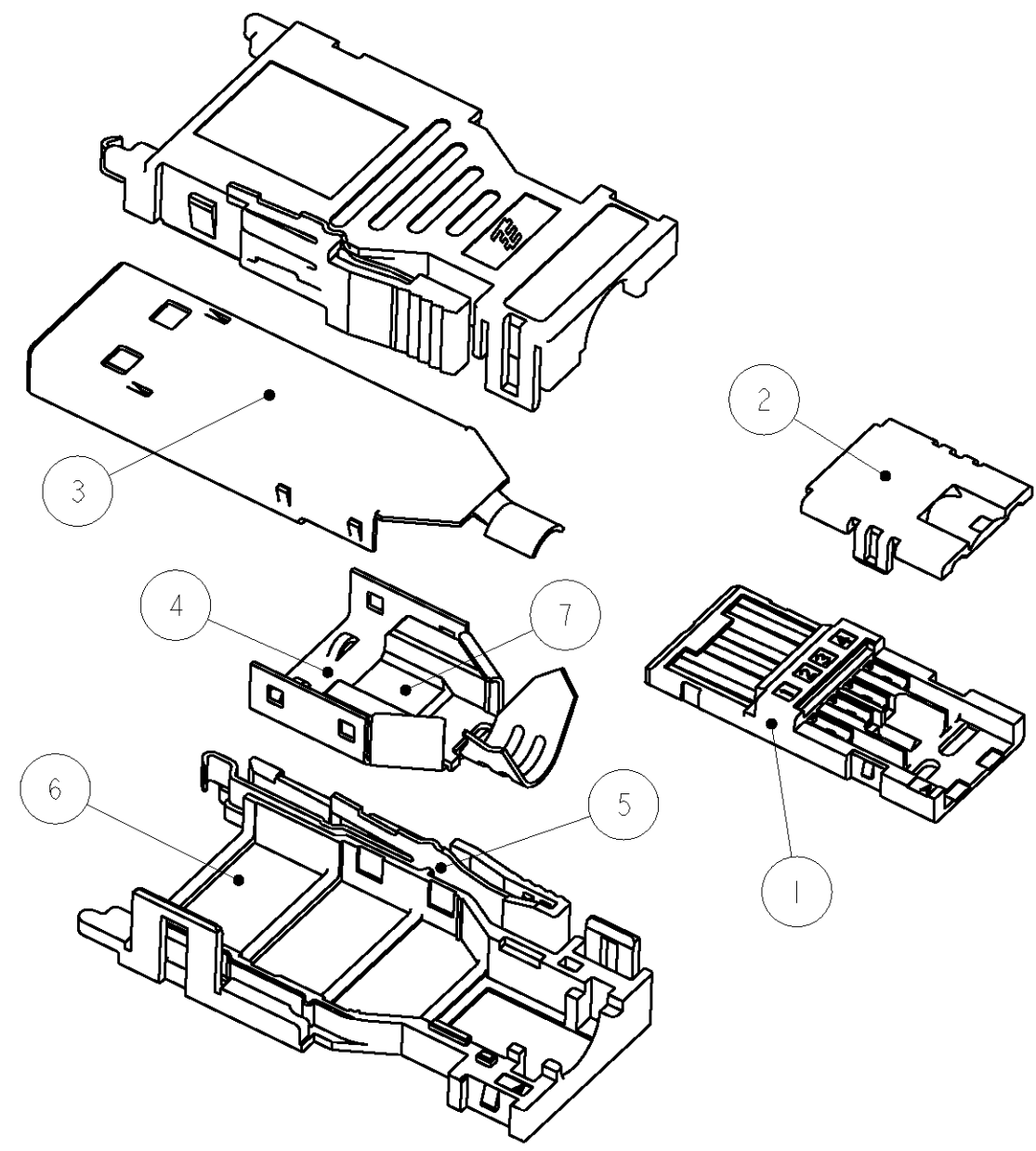
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 RELEASED FOR PUBLICATION
 20
 © COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
J	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		C		REVISED PER ECR-10-008579	11MAY10	HMR	TM



- 1: 本図
 - 1: AS SHOWN

注記
 1 本図型番は大口梱包品。
 NOTE
 1 THIS PART NUMBER IS BULK PACK STYLE.



REQUIRED PART ASSEMBLY	MATERIAL/FINISH	PART NAME	ITEM NO.
材料/仕上げ	部品名称		
1	POLYAMIDE OF GLASS FILLED PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリアミド系樹脂 UL94V-0	RETENTION HSG リテンション ハウジング	7
2	OLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入り熱可塑性ポリエステル系樹脂 UL94V-0	COVER HSG カバー ハウジング	6
2	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	LOCK SPRING ロック スプリング	5
1	STEEL/UNDER:COPPER PLATING, TOP: Ni PLATING 鋼/下地: 銅めっき, 表面: ニッケルめっき	BACK SHELL OF PLUG バック シェル	4
1	STEEL/UNDER:COPPER PLATING, TOP: Ni PLATING 鋼/下地: 銅めっき, 表面: ニッケルめっき	FRONT SHELL OF PLUG フロント シェル	3
1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入り熱可塑性ポリエステル系樹脂 UL94V-0	CAP HSG キャップ ハウジング	2
1	CONTACT(COPPER ALLOY/ UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27 μ m MIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING 0.76 μ m MIN SOLDERING AREA: Tin PLATING 2 μ m MIN) HSG(POLYAMIDE OF GLASS FILLED PLASTIC(UL94V-0)) コンタクト(銅合金/ 全面: ニッケルめっき下地 1.27 μ m以上 表面 接点部: 金めっき 0.76 μ m以上 半田付け部: 錫めっき 2 μ m以上) ハウジング(ガラス入りポリアミド系樹脂 UL94V-0)	PLUG HSG ASSY プラグ ハウジング アセンブリ	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
 IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
 SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DWN	21DEC2007	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	NAME INDUSTRIAL USB PLUG CONNECTOR KIT BULK PACK STYLE	RESTRICTED TO					
CHK	S. INOMATA								
APVD	L. HASEGAWA								
PRODUCT SPEC	108-78523								
APPLICATION SPEC	114-5434	SIZE	A3	CAGE CODE	00779	DRAWING NO	C=2040305	REVISION	C
MATERIAL	-	WEIGHT	29.9(g)	SCALE	2:1	SHEET	1	OF	1

CUSTOMER DRAWING